



#### RE900-05

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para TSOP II 40, 44 (0,80 mm)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Bajo demanda se ponen a disposición gratuitamente los datos Gerber para la fabricación de la impresión de pasta de soldar
- Tamaño 29,29 x 30,94 mm

Módulo-No.	Typ	Pitch	Pin	Tamaño (mm)
RE900-05	TSOP II	0,800 mm	40, 44	11,50 x 18,80